千附精密(6829 TT)

台灣股市｜電子上游

投 資 速 報

逢低買進-首次 目標價 NT$300 (潛在報酬+24.5%)

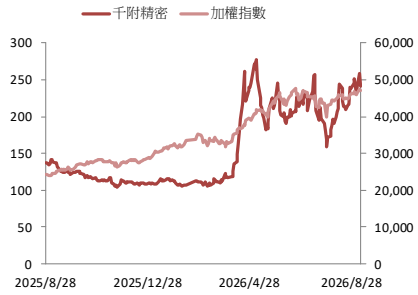
2026-09-09

半導體設備、軍工雙主力

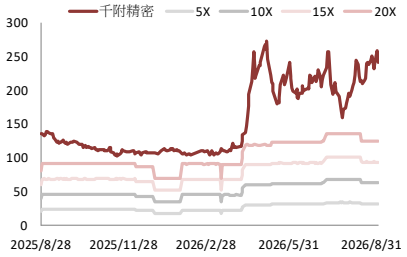
前次報告	
日期	
評等	
目標價(元)	

股價資訊	
收盤價(元)	241.00
總市值(億元)	142.7
股本(百萬)	592
一年高/低價	278 / 104.5
月成交均量(張)	1,248
月成交均值(百萬)	295.1

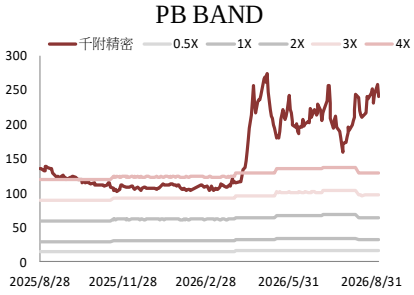
股價表現 & PE/PB



PE BAND



PB BAND



研究員/林世忠
113034@concords.com.tw

■ 結論與建議

展望 2H26~2027 年，半導體是明確且持續的成長主力，軍工下半年有望回溫並受需求提前帶動，量子電腦則為中長期新成長曲線（技術門檻高、潛在規模大，但短期仍處驗證階段），加上產能擴張，中長期成長動能明確。預估 2H26 營運逐季走高，整體獲利表現將優於營收，預估 2027 年 EPS 9.1 元，本益比為 26.5 倍，考量公司整體下半年各產業客戶需求仍強，半導體需求最明確、軍工開始補上，營運明顯成長，建議逢低買進，目標價 300 元(33*2027 年 EPS)。

■ 重點摘要

公司簡介

公司成立於 2020 年 7 月 20 日，為千附實業（8383）之子公司（母公司持股約 63%），前身為千附實業精密科技事業處。公司位於中部科學園區台中市后里區，實收資本額約 5.92 億元。主要業務為關鍵性精密零組件整合製造服務，並逐步擴展至關鍵模組與次系統垂直整合。核心產品與應用包括：半導體與光電設備、航太與國防、新興領域量子電腦等。核心技術包括精密加工、高真空焊接、特殊製程（Nadcap 等認證）、三次元量測、表面處理等。客戶涵蓋國際航太大廠、半導體設備領導廠商。2024 年底投資約 28 億元於嘉義縣馬稠後產業園區興建新廠（占地約 3.3 萬 m²），目標提升高階智能化產能，支援半導體、航太軍工與量子業務。

圖一、2Q26 產品比重



資料來源：千附精密、康和投顧整理，2026/9

以上資料為康和投顧所提供,不得轉寄
本公司不負任何法律責任，請投資人自行斟酌參考

半導體產品需求維持高檔

2Q26 營收占比 40%，客戶包括包括全球前三大半導體設備商 艾司摩爾(ASML)、應用材料(Applied Materials) 與科林研發(Lam Research)等全球前段設備大廠；並持續拓展封測設備等新客戶與新應用。產品偏重於大型真空腔體（PVD / CVD）、系統組裝、及關鍵零組件，2026-2030 年客戶預估以兩位數成長，新增開發案增加。2027 年半導體營收比重有機會突破 50%。AI/HPC/先進製程持續推動設備資本支出，2027 年營收 YOY+45~50%。

圖二、半導體相關產品



資料來源：千附精密、康和投顧整理，2026/9

軍工產品穩定貢獻

2Q26 占比 15%，已通過美國國防供應鏈 DFARS CMMC 2.0 資安評鑑，登錄美國國防合格供應商；1H26 獲洛克希德馬丁「最佳供應商獎」（唯一海外獲獎者），主要出貨愛國者飛彈相關關鍵零組件（如發射架電子控制箱等）。上半年因客戶系統轉換，出貨遞延，實質訂單並未減少，預計下半年會補上。原訂 2029 年需求有提前至 2027 年情況，目前全球愛國者飛彈庫存低於 50%，客戶有加速補庫存壓力。長期訂單能見度佳，2027 年營收 YOY+20%。

量子電腦為長線成長動能

截至今年 8 月已正式出貨 2 套低溫真空腔體（Chamber）設備給某家系統大廠客戶，目前營收占比不大(約低個位數)。2027 年將逐漸進入設備量產期（目前多數廠商仍處實驗室階段）。客戶年需求潛在 400– 800 套（產能僅能滿足約 50%）。未來有機會成為重要成長曲線，甚至追上半導體規模，但量產時程取決於客戶規劃。客戶目標 2030 年商業化，需求潛力大。

a.產品：超低溫真空腔體（耐 2K– 4K，約-271 ~ -273℃絕對低溫），大如冰箱、生產週期約 4 個月；涉及高真空焊接、極低溫密封、系統整合。

b.應用領域：主要為醫療、新藥開發、天氣預測、交通系統等（與 AI 伺服器運算有差異，替代影響有限）。

c.客戶處於初期驗證與設計調整階段，近期可望確認第二代產品規格。

受惠半導體設備、軍工強勁需求帶動，2027 年持續成長

產能布局:現有廠區生產仍以中科廠為主，搭配潭子廠的一部分區塊。嘉義新廠則以半導體相關規劃為主。目前硬體工程已進入收尾階段，預計於4Q26 取得使用執照。因設備陸續進駐(部分交期較長，可能至明年第三、四季才進駐完成)並需經過半導體客戶認證，若過程順利，預估最快在明年第二季開始逐步產生營收貢獻。

2Q26 營收 5.67 億元(QOQ-6.2%、YOY+44.7%)，受惠半導體業務(ASML、應材、Lam Research 等)貢獻近 40%，是推升整體年增的主因。軍工業務略有下滑(遞延)，光電需求較去年改善，航太相對平穩，營運明顯成長，毛利率 27.7%(2Q25 26.3%)，稅後淨利 0.81 億元，YOY+554.2%，稅後 EPS 1.36 元。

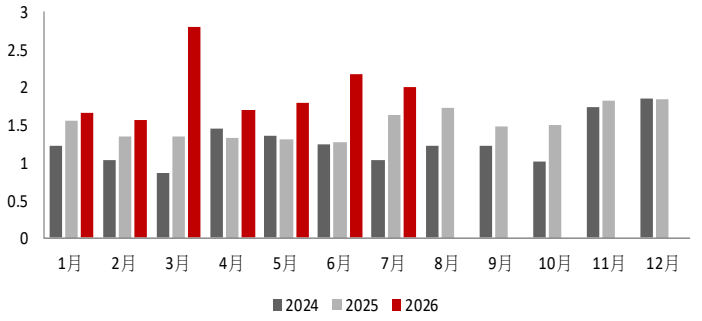
整體來看，2026 年 1~7 月累計營收 13.73 億元，YOY+39.7%。根據半導體大廠預估 2024~2030 年間，全球主要半導體設備商需求幾乎逐年皆呈雙位數比例成長，市場前景明確。加上軍工防空系統(如愛國者飛彈)因應地緣政治衝突，全球體系庫存已降至 50%以下，補充需求極其迫切，帶動公司半導體及軍工產品動能向上，預估 2027 年營收 31.63 億元，YoY+30%，隨著產能擴張、軍工產品出貨成長，有望持續帶動產品組合改善，預估毛利率 28%，稅後淨利 5.39 億元，YoY+35.4%，稅後 EPS 9.1 元。

	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	517	604	567	601	661	1,822	2,433	3,163
QOQ(%)	6.3	17.0	(6.2)	6.0	10.0	-	-	-
YOY(%)	14.2	41.6	44.7	23.6	27.9	19.9	33.6	30.0
毛利率(%)	24.2	26.2	27.7	28.0	28.5	27.2	27.6	28.0
營業利益率(%)	15.0	17.6	17.7	19.0	19.5	16.3	18.5	19.5
稅後淨利(百萬元)	78	97	81	104	116	234	398	539
QOQ(%)	27.3	24.5	(16.7)	29.5	11.4	-	-	-
YOY(%)	(33.4)	16.7	554.2	71.0	49.6	(30.2)	70.1	35.4
EPS(元)	1.31	1.63	1.36	1.76	1.96	3.95	6.72	9.10

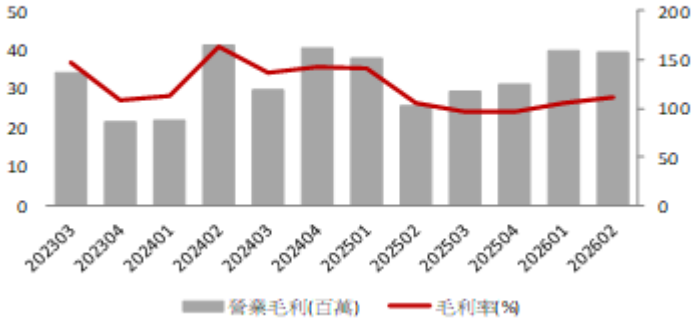
EPS以股本59.2百萬股計算

本公司不負任何法律責任，請投資人自行斟酌參考

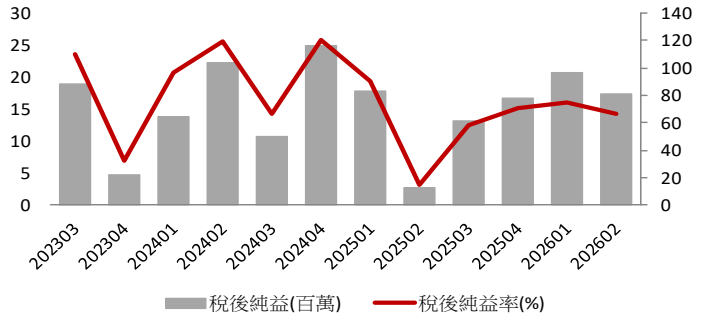
近三年營收狀況(億)



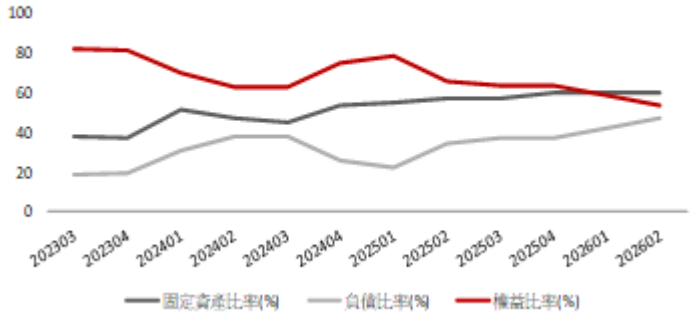
近12季_營業毛利 & 毛利率



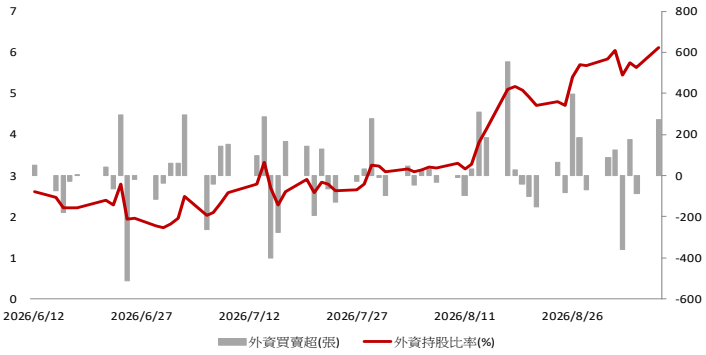
近12季_稅後純益 & 稅後純益率



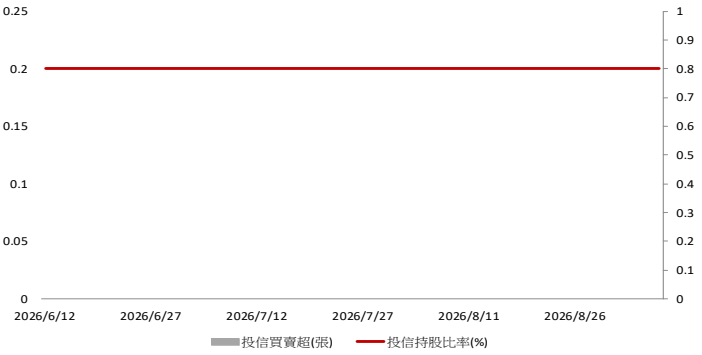
近12季_固定資產比率 & 負債比率 & 權益比率



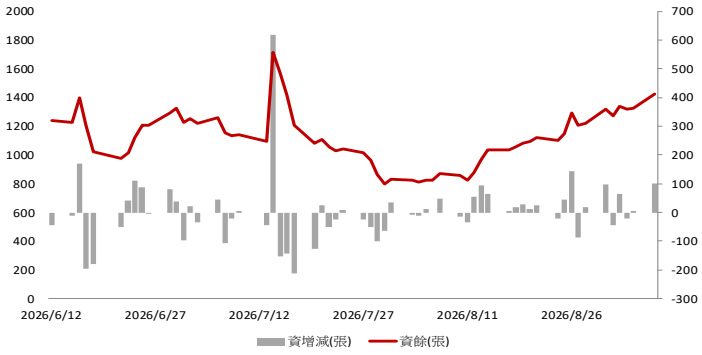
外資_持股比例 & 買賣超



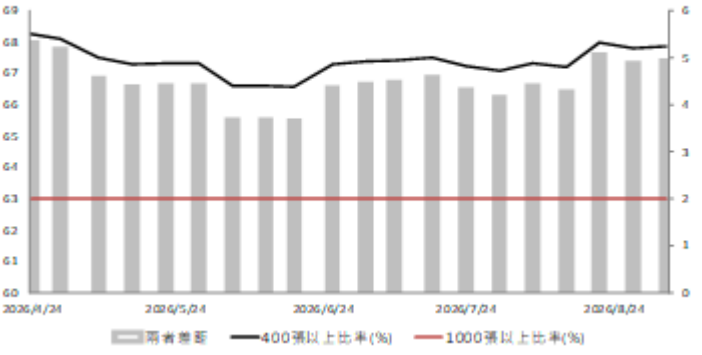
投信_持股比例 & 買賣超



融資餘額 & 資增減



近20周持股400張 & 1000張以上比例變化



評等說明

1) 強力買進/Strong Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 50%
2) 買進/Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 25%
3) 逢低買進/Trading Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間小於 25%
4) 未評等/Not Rated：至目前我們沒有足夠基本資料判斷該公司評等；或此期間康和與該公司有特定交易，基於規範或康和政策，限制予該公司評等

免責宣言:

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。